

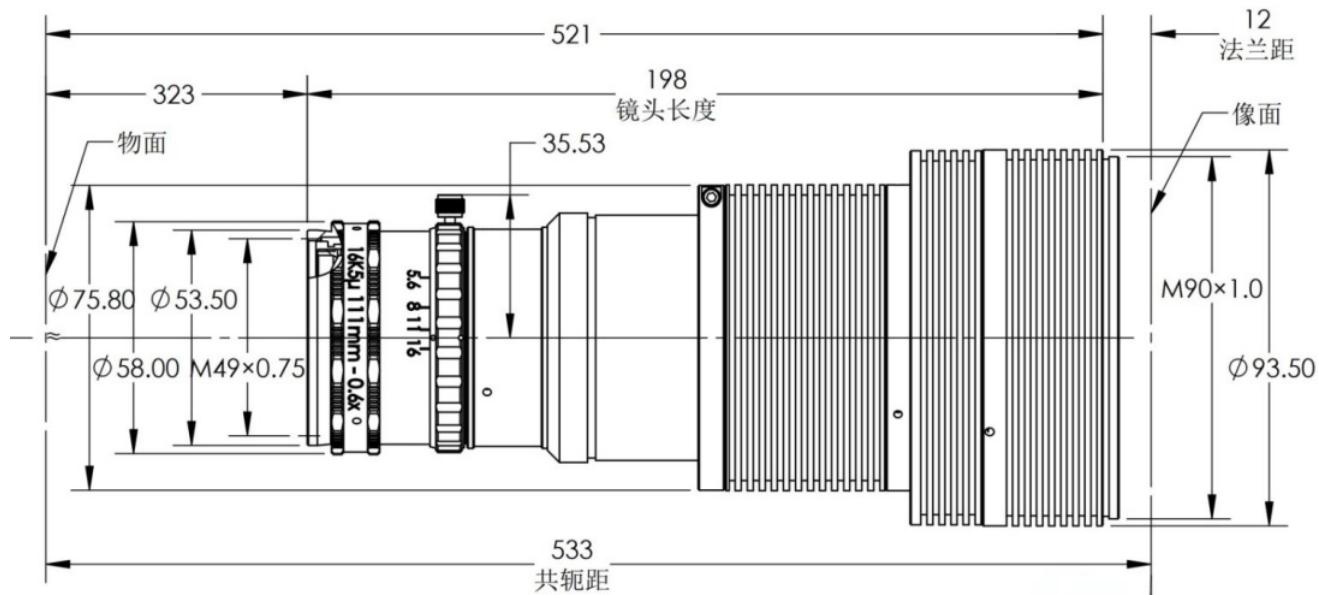
型号	JC-LS16K-0.6X
焦距	111.3mm
芯片尺寸	82IC 16K5 μ m
光圈	F5.6-F16
工作距离	323mm
共轭距	533mm
最大畸变	0.014%
放大倍率	0.6X
接口	M72/M90
滤镜尺寸	M49x0.75
重量	g
温度范围	+5°C ~ +45°C

特点:

1. 大像面，最大像面 ϕ 82mm，适用于最大 16K5 μ m 芯片尺寸
2. 无热化设计：+5°C ~ +45°C 不虚焦
3. 画面中心和边缘更好的亮度均匀性
4. 超低光学畸变：最大畸变 < 0.014%
5. 高分辨率表现：5 μ m 像元成像过度像素 ≤ 2 像素格
6. 抗震紧固调焦方式

测量视野	物方测量精度	相机芯片
136mm	8.3 μ m	16384x5 μ m
95.8mm	11.7 μ m	8192x7 μ m
95.8mm	5.8 μ m	16384x3.5 μ m
102mm	8.3 μ m	12288x5 μ m

产品尺寸： (单位mm)



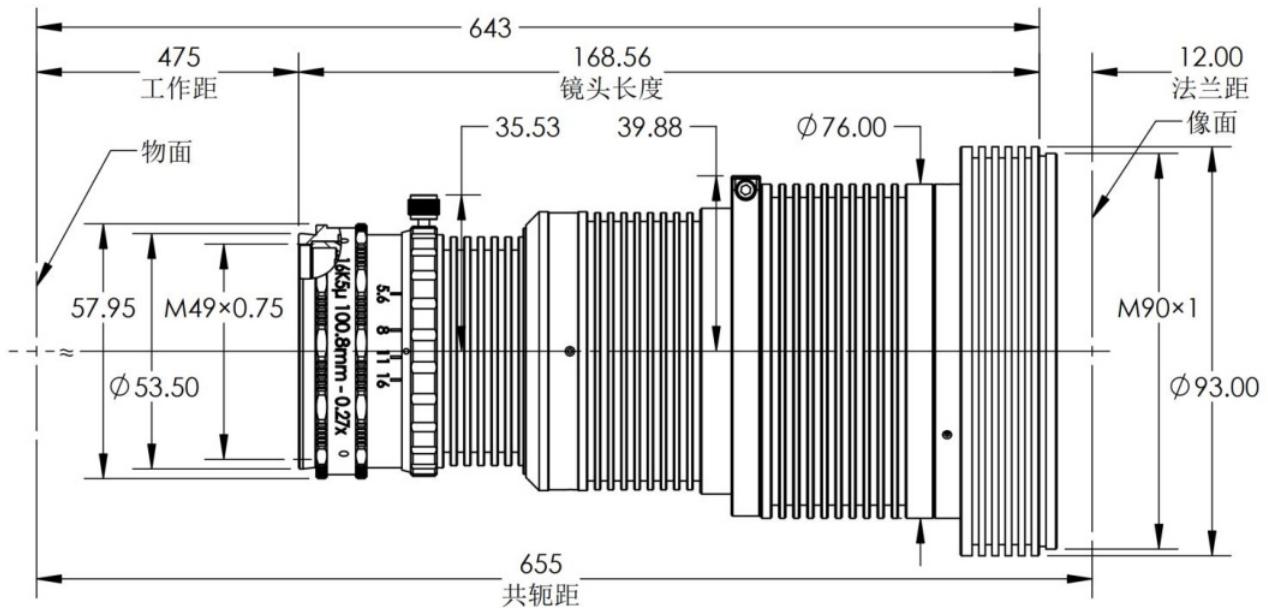
型 号	JC-LS16K-0.27X
焦 距	100.8mm
芯片尺寸	82IC 16K5 μ m
光 圈	F5.6-F16
工作距离	475mm
共 轨 距	655mm
最大畸变	0.012%
放大倍率	0.27X
接 口	M72/M90
滤镜尺寸	M49x0.75
重 量	g
温度范围	+5°C ~ +45°C

特点：

1. 大像面：最大像圆 Φ 82mm，适用于最大16K5 μ m芯片尺寸
 2. 无热化设计：+5°C~+45°C不虚焦
 3. 画面中心和边缘更好的亮度均匀性
 4. 超低光学畸变：最大畸变<0.012%
 5. 高分辨率表现：5 μ m像元成像过度像素≤2像素格
 6. 抗震紧固调焦方式

测量视野	物方测量精度	相机芯片
303.4mm	18.5 μ m	16384x5 μ m
212.4mm	25.9 μ m	8192x7 μ m
212.4mm	13 μ m	16384x3.5 μ m
227.6mm	18.5 μ m	12288x5 μ m

产品尺寸：（单位mm）



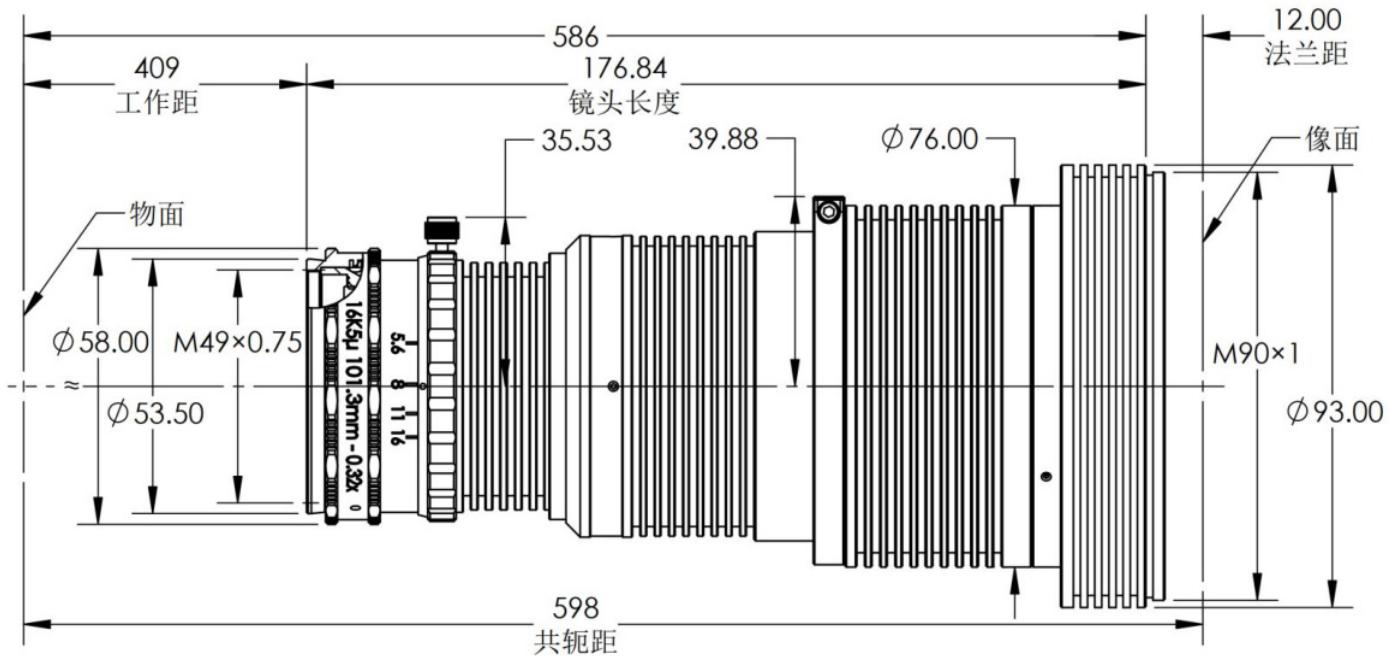
型 号	JC-LS16K-0.33X
焦 距	101.3mm
芯片尺寸	82IC 16K5 μ m
光 圈	F5.6-F16
工作距离	409mm
共轭距	598mm
最大畸变	0.021%
放大倍率	0.33X
接 口	M72/M90
滤镜尺寸	M49x0.75
重 量	g
温度范围	+5°C ~ +45°C

特点:

1. 大像面: 最大像圆 ϕ 82mm, 适用于最大16K5 μ m芯片尺寸
2. 无热化设计: +5°C ~ +45°C 不虚焦
3. 画面中心和边缘更好的亮度均匀性
4. 超低光学畸变: 最大畸变 < 0.021%
5. 高分辨率表现: 5 μ m 像元成像过度像素 ≤ 2 像素格
6. 抗震紧固调焦方式

测量视野	物方测量精度	相机芯片
248.2mm	15.2 μ m	16384x5 μ m
173.8mm	21.2 μ m	8192x7 μ m
173.8mm	10.6 μ m	16384x3.5 μ m
186.2mm	15.2 μ m	12288x5 μ m

产品尺寸: (单位mm)



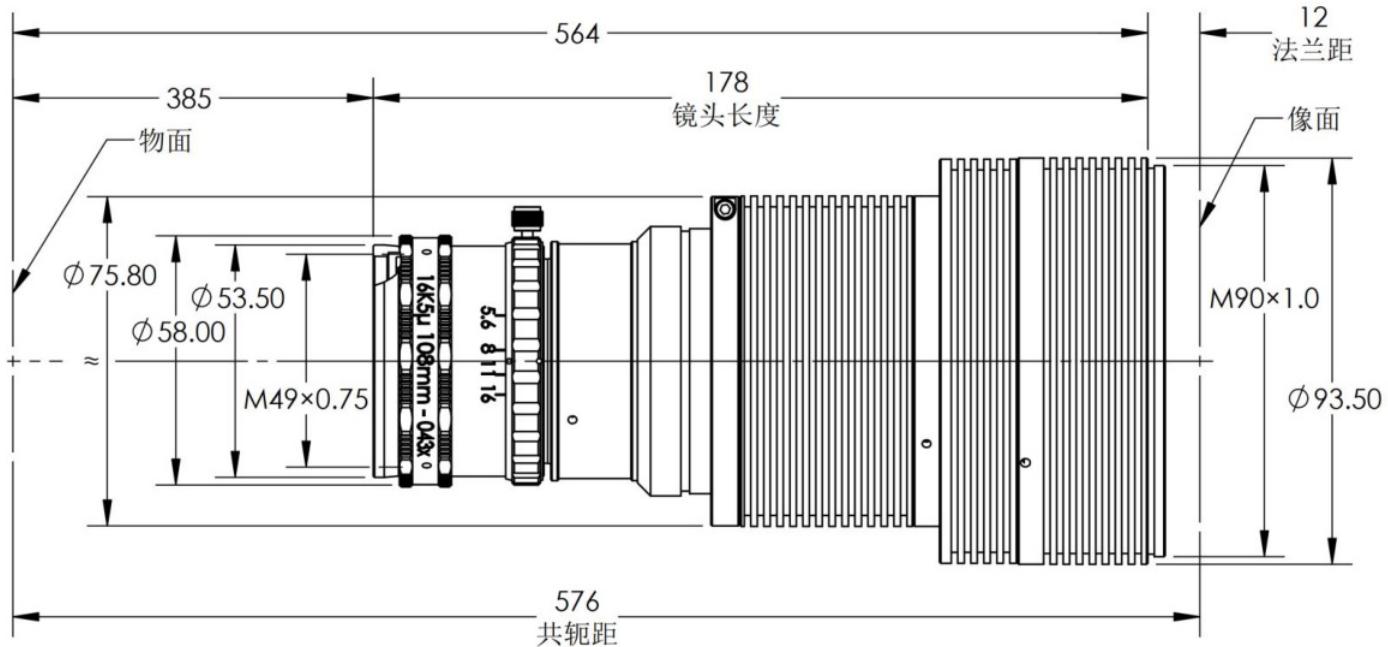
型 号	JC-LS16K-0.45X	
焦 距	108.4mm	
芯片尺寸	82IC 16K5 μ m	
光 圈	F5.6-F16	
工作距离	385mm	
共 轨 距	576mm	
最大畸变	0.015%	
放大倍率	0.43X	
接 口	M72/M90	
滤镜尺寸	M49x0.75	
重 量	g	
温度范围	+5°C ~ +45°C	

特点:

1. 大像面: 最大像圆 ϕ 82mm, 适用于最大 16K5 μ m 芯片尺寸
2. 无热化设计: +5°C ~ +45°C 不虚焦
3. 画面中心和边缘更好的亮度均匀性
4. 超低光学畸变: 最大畸变 < 0.015%
5. 高分辨率表现: 5 μ m 像元成像过度像素 ≤ 2 像素格
6. 抗震紧固调焦方式

测量视野	物方测量精度	相机芯片
190.5mm	11.6 μ m	16384x5 μ m
133.4mm	16.3 μ m	8192x7 μ m
133.4mm	8.1 μ m	16384x3.5 μ m
142.9mm	11.6 μ m	12288x5 μ m

产品尺寸: (单位mm)



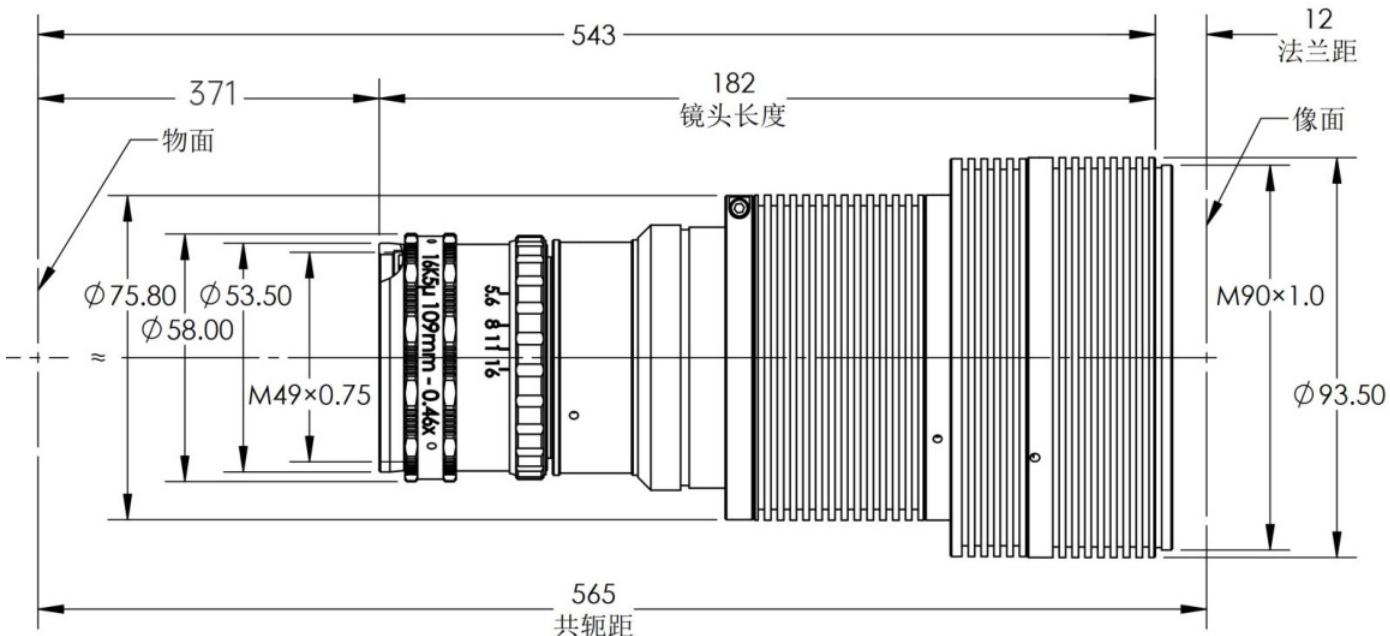
型 号	JC-LS16K-0.46X
焦 距	108.2mm
芯片尺寸	82IC 16K5 μ m
光 圈	F5.6-F16
工作距离	371mm
共 轼 距	565mm
最大畸变	0.019%
放大倍率	0.46X
接 口	M72/M90
滤镜尺寸	M49x0.75
重 量	g
温度范围	+5°C ~ +45°C

特点:

1. 大像面: 最大像圆 ϕ 82mm, 适用于最大 16K5 μ m 芯片尺寸
2. 无热化设计: +5°C ~ +45°C 不虚焦
3. 画面中心和边缘更好的亮度均匀性
4. 超低光学畸变: 最大畸变 < 0.019%
5. 高分辨率表现: 5 μ m 像元成像过度像素 ≤ 2 像素格
6. 抗震紧固调焦方式

测量视野	物方测量精度	相机芯片
178.1mm	10.9 μ m	16384x5 μ m
124.7mm	15.2 μ m	8192x7 μ m
124.7mm	7.6 μ m	16384x3.5 μ m
133.6mm	10.9 μ m	12288x5 μ m

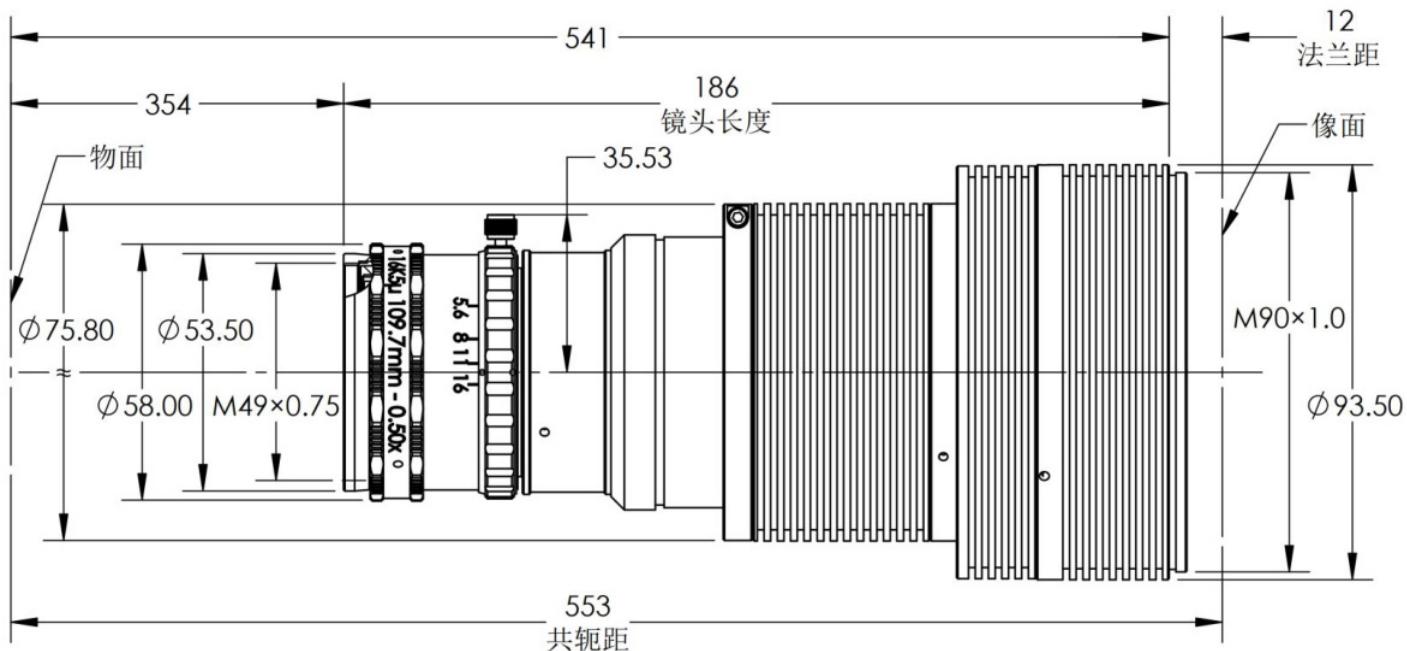
产品尺寸: (单位mm)



型 号	JC-LS16K-0.50X	特点： 1.大像面：最大像圆 $\phi 82\text{mm}$, 适用于最大16K5 μm 芯片尺寸 2.无热化设计：+5°C~+45°C不虚焦 3.画面中心和边缘更好的亮度均匀性 4.超低光学畸变：最大畸变<0.019% 5.高分辨率表现：5 μm 像元成像过度像素≤2像素格 6.抗震紧固调焦方式
焦 距	110mm	
芯 片 尺 寸	82IC 16K5 μm	
光 圈	F5.6-F16	
工 作 距 离	354mm	
共 轨 距	553mm	
最 大 畸 变	0.019%	
放 大 倍 率	0.50X	
接 口	M72/M90	
滤 镜 尺 寸	M49x0.75	
重 量	g	
温 度 范 围	+5°C~+45°C	

测 量 视 野	物 方 测 量 精 度	相 机 芯 片
163.8mm	10 μm	16384x5 μm
114.7mm	14 μm	8192x7 μm
114.7mm	7 μm	16384x3.5 μm
122.9mm	10 μm	12288x5 μm

产品尺寸：（单位mm）



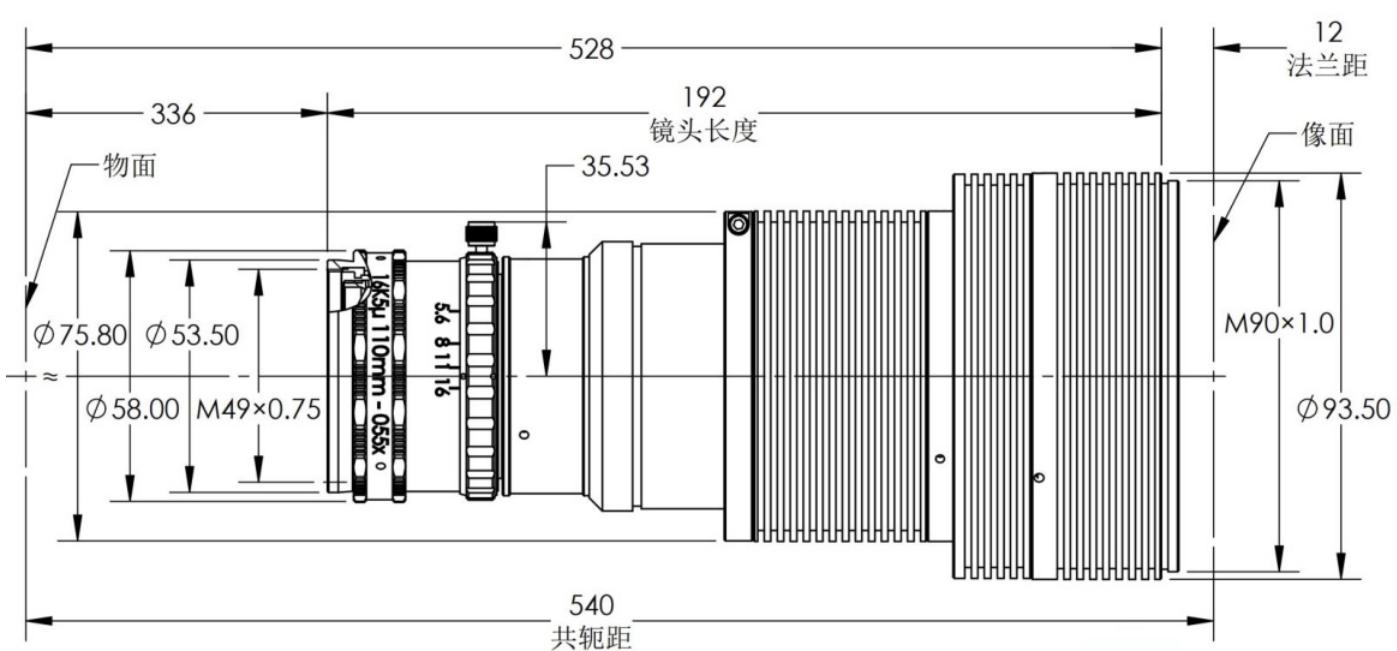
型 号	JC-LS16K-0.55X
焦 距	110mm
芯片尺寸	82IC 16K5 μ m
光 圈	F5.6-F16
工作距离	336mm
共 距	540mm
最大畸变	0.019%
放大倍率	0.55X
接 口	M72/M90
滤镜尺寸	M49x0.75
重 量	g
温度范围	+5°C ~ +45°C

特点:

- 1.大像面: 最大像圆 Φ 82mm, 适用于最大16K5 μ m芯片尺寸
- 2.无热化设计: +5°C ~ +45°C 不虚焦
- 3.画面中心和边缘更好的亮度均匀性
- 4.超低光学畸变: 最大畸变<0.019%
- 5.高分辨率表现: 5 μ m像元成像过度像素≤2像素格
- 6.抗震紧固调焦方式

测量视野	物方测量精度	相机芯片
148.9mm	9.1 μ m	16384x5 μ m
104.3mm	12.7 μ m	8192x7 μ m
104.3mm	6.4 μ m	16384x3.5 μ m
117.1mm	9.1 μ m	12288x5 μ m

产品尺寸: (单位mm)



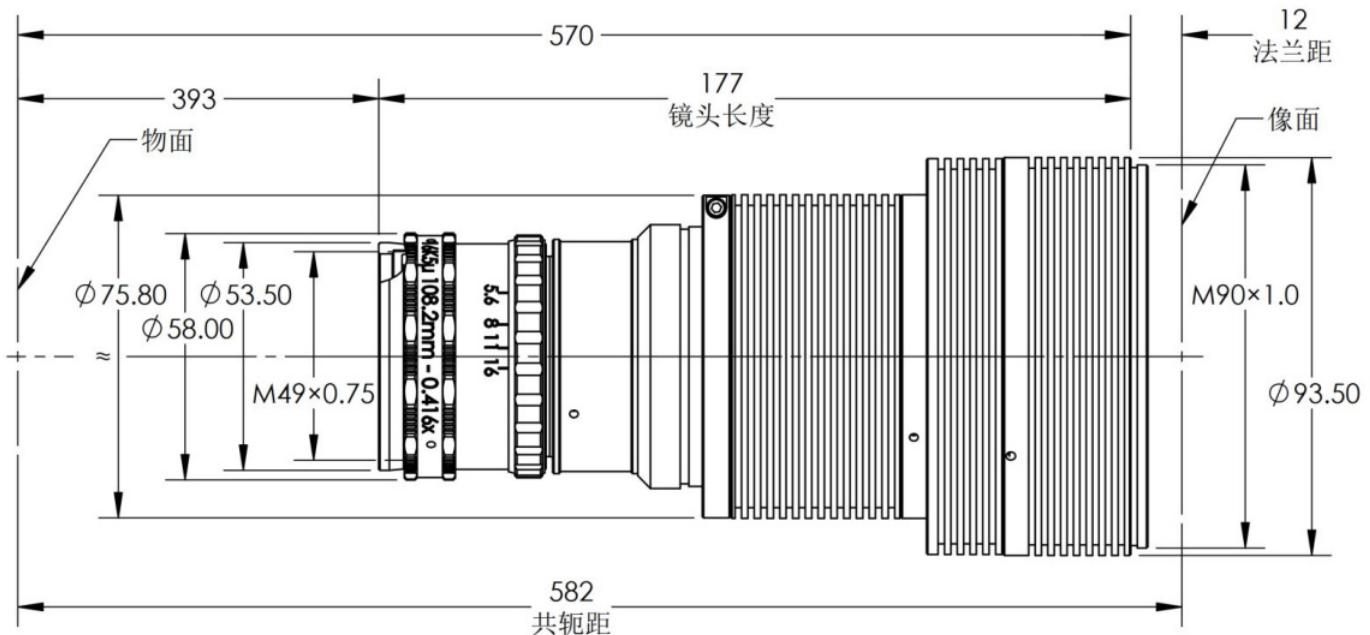
型 号	JC-LS16K-0.416X	
焦 距	108.2mm	
芯片尺寸	82IC 16K5 μ m	
光 圈	F5.6-F16	
工作距离	393mm	
共 距 距	582mm	
最大畸变	0.016%	
放大倍率	0.416X	
接 口	M72/M90	
滤镜尺寸	M49x0.75	
重 量	g	
温度范围	+5°C ~ +45°C	

特点:

- 1.大像面: 最大像圆 Φ 82mm, 适用于最大16K5 μ m芯片尺寸
- 2.无热化设计: +5°C ~ +45°C 不虚焦
- 3.画面中心和边缘更好的亮度均匀性
- 4.超低光学畸变: 最大畸变<0.016%
- 5.高分辨率表现: 5 μ m像元成像过度像素≤2像素格
- 6.抗震紧固调焦方式

测量视野	物方测量精度	相机芯片
196.9mm	12 μ m	16384x5 μ m
137.8mm	16.8 μ m	8192x7 μ m
137.8mm	8.4 μ m	16384x3.5 μ m
147.7mm	12 μ m	12288x5 μ m

产品尺寸: (单位mm)



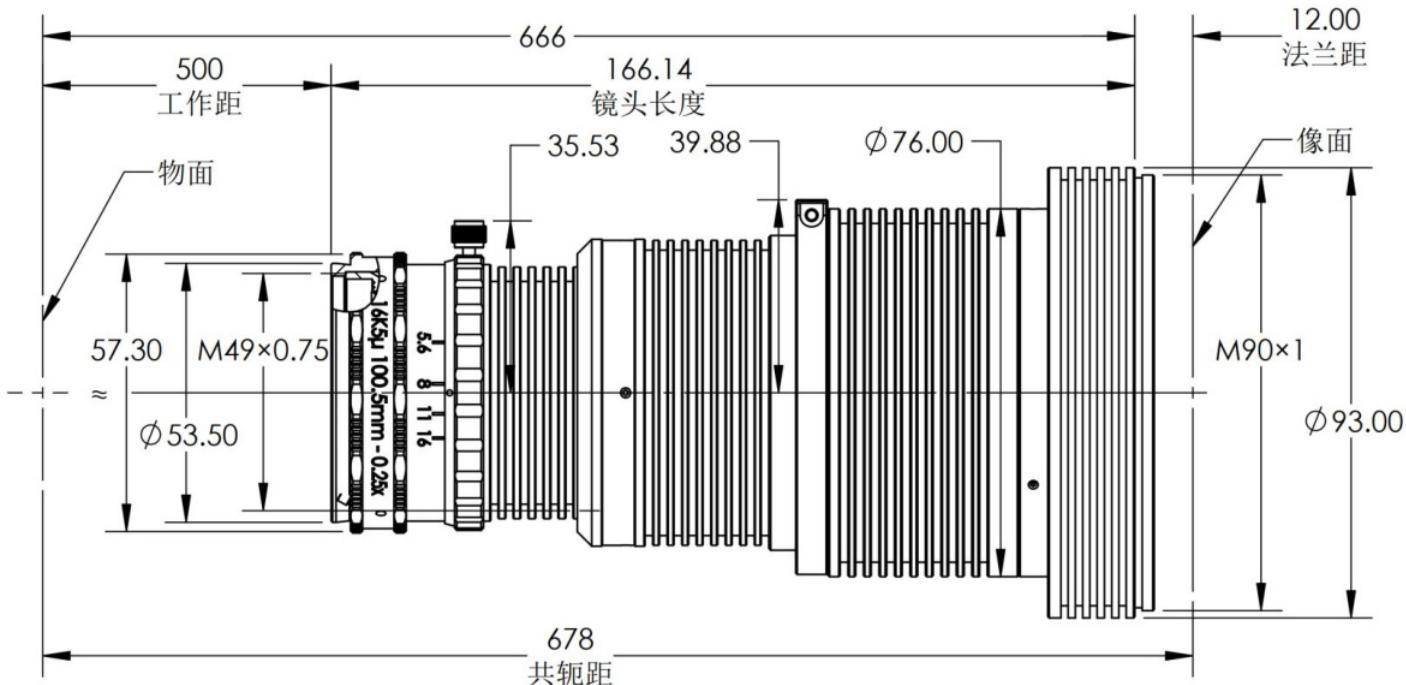
型 号	JC-LS16K-0.2525X
焦 距	100.5mm
芯片尺寸	82IC 16K5 μ m
光 圈	F5.6-F16
工作距离	500mm
共 轴 距	678mm
最大畸变	0.015%
放大倍率	0.2525X
接 口	M72/M90
滤镜尺寸	M49x0.75
重 量	g
温度范围	+5°C ~ +45°C

特点:

- 1.大像面: 最大像圆 ϕ 82mm, 适用于最大16K5 μ m芯片尺寸
- 2.无热化设计: +5°C ~ +45°C 不虚焦
- 3.画面中心和边缘更好的亮度均匀性
- 4.超低光学畸变: 最大畸变<0.015%
- 5.高分辨率表现: 5 μ m像元成像过度像素≤2像素格
- 6.抗震紧固调焦方式

测量视野	物方测量精度	相机芯片
324.4mm	19.8 μ m	16384x5 μ m
277.1mm	21.8 μ m	8192x7 μ m
227.1mm	10.9 μ m	16384x3.5 μ m
243.3mm	19.8 μ m	12288x5 μ m

产品尺寸: (单位mm)



型 号	JC-LS16K-0.3205X	
焦 距	101.3mm	
芯片尺寸	82IC 16K5 μ m	
光 圈	F5.6-F16	
工作距离	418mm	
共 轼 距	605mm	
最大畸变	0.016%	
放大倍率	0.3205X	
接 口	M72/M90	
滤镜尺寸	M49x0.75	
重 量	g	
温度范围	+5°C ~ +45°C	

特点：

- 1.大像面：最大像圆 ϕ 82mm，适用于最大16K5 μ m芯片尺寸
- 2.无热化设计：+5°C ~ +45°C 不虚焦
- 3.画面中心和边缘更好的亮度均匀性
- 4.超低光学畸变：最大畸变<0.016%
- 5.高分辨率表现：5 μ m像元成像过度像素≤2像素格
- 6.抗震紧固调焦方式

测量视野	物方测量精度	相机芯片
255.6mm	15.6 μ m	16384x5 μ m
178.9mm	21.8 μ m	8192x7 μ m
178.9mm	10.9 μ m	16384x3.5 μ m
191.7mm	15.6 μ m	12288x5 μ m

产品尺寸：（单位mm）

